
股票代码：002288

股票简称：超华科技



广东超华科技股份有限公司
2017 年非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告

二〇一七年七月

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,330.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）	42,294.16	36,994.00
年产 600 万张高端芯板项目	37,565.93	31,040.00
年产 700 万平方米 FCCL 项目	26,575.29	20,296.00
合计	106,435.38	88,330.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）
- 2、项目建设单位：广东超华科技股份有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市
- 4、项目性质：扩建
- 5、主要产品：6 μ m 电子铜箔、8 μ m-10 μ m 电子铜箔
- 6、项目总投资：项目总投资 42,294.16 万元，其中建设投资 38,871.94 万元，铺底流动资金 3,422.21 万元
- 7、项目建设周期：24 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，引进国际先进设备，构建年产能 5,000 吨的电子铜箔生产线，其中 6 μ m 电子铜箔 3,000 吨、8 μ m-10 μ m 电子铜箔 2,000 吨。

（二）项目实施的必要性

1、高精度铜箔是电子铜箔行业的发展方向

电子铜箔根据制造工艺来分，可以分为压延铜箔和电解铜箔。

产品名称	制造工艺类型		应用方向	厚度		
电子铜箔	压延铜箔		铜锭熔炼为铜板后，通过辊压和粗化处理、耐热处理及防氧化处理等一系列表面处理得到	工艺品装饰、挠性电路板（FPC）	≤0.1mm	
	电解铜箔	标准铜箔	铜锭经溶解制成硫酸铜电解液，在直流电作用下电沉积得到	一面光面（S面），一面毛面（M面）	覆铜板（CCL）、印刷电路板（PCB）	5-105μm
		锂电铜箔		两面光面	锂离子电池的负极集流体	6-20μm

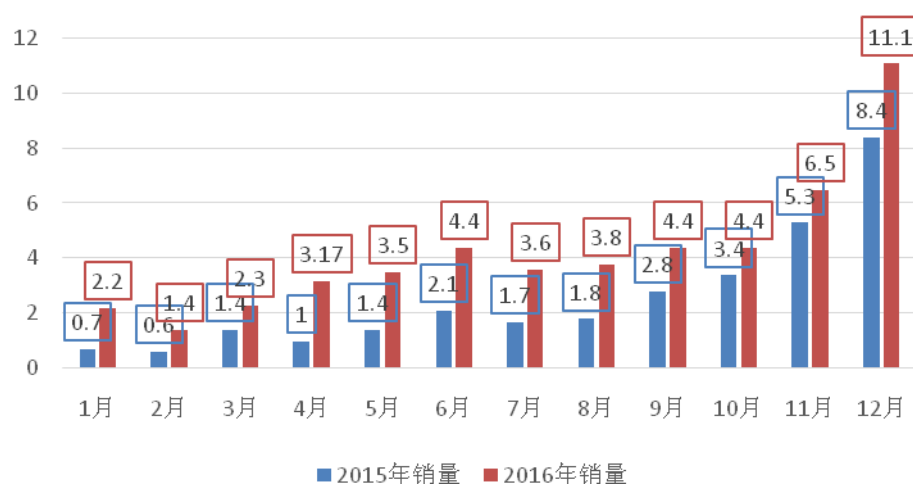
本项目拟采用电解技术制造 6μm 级、8μm-10μm 级高精度电子铜箔，产品可用于新能源汽车动力锂电池负极集流体和印制电路板所需的覆铜板。

标准铜箔经过多年的竞争整合，落后产能逐步淘汰，目前主流产品厚度已经降为 18 -35μm。而锂电铜箔主要用作负极材料载体，对产品的一致性和稳定性要求更高，主流厚度为 7-9μm。为了应对将来消费级电子产品轻薄化可穿戴化，锂电池体积小量化、能量密度快速提升的发展趋势，标准铜箔和锂电铜箔的厚度必将进一步压缩，因而高精度铜箔将是电子铜箔发展的必然方向。

2、新能源汽车行业快速发展，锂电铜箔供给出现巨大缺口

2016 年新能源汽车快速发展，有力拉动了锂电池需求。中国汽车工业协会发布的数据显示，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。随着 2017 年 6 月 2 日工信部发布第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，新能源汽车补贴退坡影响将逐渐消退，根据全国乘用车联合会预计，2017 年新能源汽车销量可达 70 万辆，继续保持高速增长势头。

2015年-2016年新能源汽车销量（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车使用的电池主要为动力锂电池，其具有能量密度高、输出功率大、自重轻、使用寿命长等优点。此外，锂电池的种类还包括用于手机、平板等电子设备的3C锂电池，以及用于家庭光储能、基站备用电源、电网储能等用途的广义储能锂电池。

锂电铜箔需求端受动力锂电池拉动，需求增长加速。锂电铜箔是锂电池中不可或缺的重要材料，在锂电池的结构设计中，石油焦和石墨等负极材料需涂敷于导电集流体材料上，锂电铜箔因具有良好的导电性、耐腐蚀性、抗氧化性及原材料成本低廉等特征，成为了锂电池集流体的首选。根据测算，锂电铜箔在动力电池中用量和储能电池中用量约为900吨/GWh，在3C电池中用量约为700吨/GWh，保守预计2017-2020年锂电铜箔的总需求量分别可达5.42万吨、6.65万吨、8.68万吨、11.42万吨，年复合增速约28.2%。

表：2016-2020年锂电铜箔需求量

	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
我国新能源汽车销量（万辆）	50.7	69.7	102.8	146.5	194.6
环比增速（%）	65.69%	37.48%	47.49%	42.51%	32.83%
——动力用锂电池需求（GWh）	25.72	34.74	47.00	67.92	96.68
——3C用锂电池需求（GWh）	27.00	28.35	29.77	31.26	32.82
——储能用锂电池需求（GWh）	3.16	3.48	3.82	4.21	4.63
锂电池需求量（GWh）	55.88	66.57	80.59	103.39	134.13
——动力电池锂电铜箔需求（万吨）	2.32	3.13	4.23	6.11	8.70

——3C 电池锂电铜箔需求（万吨）	1.89	1.98	2.08	2.19	2.30
——储能用锂电铜箔需求（万吨）	0.28	0.31	0.34	0.38	0.42
锂电铜箔需求量（万吨）	4.49	5.42	6.65	8.68	11.42
环比增速（%）		20.81%	22.75%	30.37%	31.51%

数据来源：高工产研锂电研究所

锂电铜箔供给端存量产能严重不足，增量供给提升缓慢，供求两端存在巨大缺口。锂电铜箔增量供给来自三方面：新增产能、标准铜箔转向锂电铜箔以及国外进口。

（1）从新增产能看：锂电铜箔进入壁垒较高，壁垒主要在于生产设备和工艺。核心设备阴极辊依赖进口，定制和调试周期长，因此锂电铜箔扩产周期在 1.5-2 年左右。同时，铜箔生产环保要求严、投资规模大、运营成本高也制约大规模扩产。

（2）从标准铜箔转产锂电铜箔看：技术上锂电铜箔对产品厚度要求更薄，转产需对现有生产线进行升级改造，而且产成品认证周期较长。市场供求上，标准铜箔需求稳健增长，部分产能转向锂电铜箔后造成供给收缩，也出现供给紧张的局面，因此后续再转到锂电铜箔的空间有限。

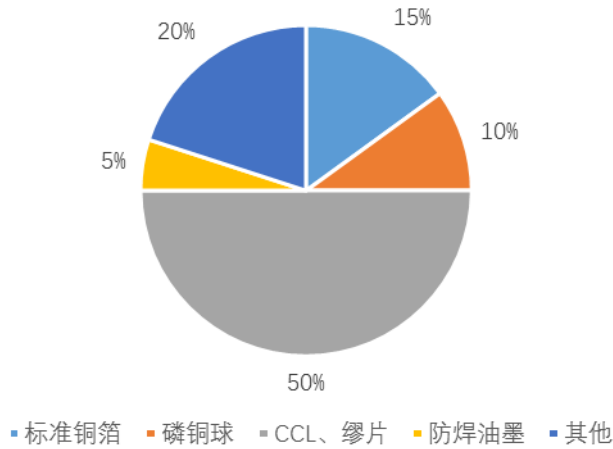
（3）从国外进口来看：目前海外市场供需基本平衡，扩产速度更慢。

综合来看，在新能源汽车和锂电池行业快速发展的推动下，锂电铜箔需求侧增长较快，供给侧受新增产能释放困难的影响增长缓慢，因此锂电铜箔供应短缺局面仍将持续。

3、标准铜箔市场转暖，供需平衡偏紧

PCB 作为电子产品的基础元器件，伴随着下游应用领域消费电子、通讯设备、工控设备、汽车电子、节能照明、智能安防、航空航天及军工产品等领域的快速发展，特别是近几年来汽车电子、小间距 LED、高端服务器等高附加值、高成长性产业的迅猛发展，PCB 产业将进入新一轮景气周期。根据电子行业咨询机构 PrismaMark 统计，2016 年中国大陆 PCB 产值达到 271.04 亿美元，年增长率为 1.43%。标准铜箔是制造 PCB 的主要原材料，在 PCB 产品成本中占据约 15% 的比例，市场空间依旧广阔。

PCB产品成本构成情况



数据来源：中国产业信息网

受锂电池行业快速发展的推动，电子铜箔行业需求回暖明显。由于部分国内外铜箔供应商将部分或全部产能由标准铜箔转移至锂电铜箔，导致目前市场出现锂电铜箔和标准铜箔都供应紧张的局面；另外前次供给侧结构调整后大量国内外厂家转产、出售和关闭，导致大量产能退出 PCB 产品供应链，造成了目前标准铜箔供应偏紧的局面。由于铜箔生产的技术和设备门槛高、投资金额大且扩产周期长，短期之内标准铜箔供应短缺的情况难以缓解，供不应求的情况仍将继续维持。

（三）项目实施的可行性

1、公司在电子铜箔领域拥有较强的技术积累

随着锂电池对锂电铜箔在性能、厚薄度上要求越来越高，铜箔的加工工艺难度也越来越大。由于锂电铜箔生产加工工艺水平较高，对精度要求十分严格，因此锂电铜箔的生产存在较高的技术壁垒。同时高端锂电铜箔的生产设备需要进口，对新进者的资金门槛较高，在资金及技术双重门槛的限制下，预计锂电铜箔市场需求在短期内难以得到满足。

公司是我国较早从事铜箔生产的企业之一，曾参与国家“863 计划”并在过程中积累了一批与铜箔相关的技术及生产工艺。深厚的技术及生产工艺积累为本项目顺利实施打下了坚实的基础。公司取得的电解铜箔相关技术专利情况如下：

序号	专利名称
1	电解铜箔缓流分液装置
2	电解铜箔真空上液装置
3	一种节能环保电解铜箔生液溶铜装置

2、公司具备完善的销售渠道和优质的合作伙伴，保障产品销售

公司长期从事铜箔产品的生产，与大批客户形成了稳定的合作关系，与多个国内外知名企业展开了深度的战略合作，建立起了覆盖全国各地和海外市场的销售网络。目前公司年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（一期）已于 2017 年 5 月投产，可年产 3000 吨 6-8um 精度的高精度锂电铜箔，在营销渠道方面公司已经做了充分准备。

（四）项目投资估算

本项目总投资 42,294.16 万元，其中建设投资 38,871.94 万元，铺底流动资金 3,422.21 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 36,994.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 13.22%，投资回收期（税后）为 8.13 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得广东省发展和改革委员会出具的《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编号 111400335129005），以及广东省环保厅出具的关于公司年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程环境影响报告书的批复（粤环审[2011]529 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

三、年产 600 万张高端芯板项目

（一）项目基本情况

1、项目名称：年产 600 万张高端芯板项目

- 2、项目建设单位：梅州超华电子绝缘材料有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市
- 4、项目性质：新建
- 5、主要产品：FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板
- 6、项目总投资：本项目总投资 37,565.93 万元，其中建设投资 32,615.60 万元，铺底流动资金 4,950.33 万元
- 7、项目建设周期：12 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，新增年产量 550 万片 FR4-HDI 专用薄板产能及 50 万片高频覆铜板产能。

（二）项目实施的必要性

1、FR4-HDI 板材符合未来市场发展的需求方向

FR4 是一种耐燃材料等级的代号，所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格，适合应用于高性能电子绝缘要求的产品。目前 FR4 型芯板是 PCB 行业应用领域最广泛的耐燃材料，具备广阔的市场空间。

HDI（High Density Interconnector）高密度互连板，即使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI 与其他产品的主要区别如下表：

产品类型	主要特性	优点	应用范围
刚性板（RPC, Rigid Printed Circuitboard）	不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印刷线路板	可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑	计算机、网络设备、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子
挠性板（FPC, Flexible Printed Circuitboard）	柔性基材制成的印刷线路板	可以弯曲，便于电器部件的组装	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
金属芯板	金属基材作为底板，表面附上绝缘介质层	散热性好、机械加工性能佳	LED照明、显示、汽车、工业电源设备、通讯设备、音频设备
高密度互联板（HDI, High Density Interconnector）	以常规多层板为芯板，再逐层叠加绝缘层和线路层，使整块印刷电路板形成层间连接	大幅度提高板件布线密度，实现印制板产品的高密度化、小型化发展	手机、笔记本、数码相机等消费类电子产品

电子产品设计在不断提高整机性能的同时，也走向轻薄化、便携化，高密度集成技术在使终端产品满足电子性能和效率等更高设计标准的同时，实现了电子元器件在板材上的集约化。HDI 目前广泛应用于手机、数码（摄）像机、MP3、MP4、笔记本电脑、汽车电子和其他数码产品等，其中以手机的应用最为广泛。据电子行业咨询机构 PrismaMark 在 2017 年 3 月“CPCA 春季论坛”作的报告，2016-2021 年 HDI 板和挠性板（包括刚挠结合板）的年复合增长率超过传统 PCB 产品，分别为 2.8% 和 3.0%。

2、满足 PCB 行业的尖端需求

高频覆铜板，即电磁频率在 1GHz 以上的特种线路板。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高，常用于卫星接收器、基地天线、微波传输、汽车电话、全球定位系统、卫星通信、通信器材转接器、接收器、信号振荡器、家庭电器联网、高速运行计算机、示波器、IC 测试仪器等等，以及高频通信、高速传输、高保密性、高传送质量、高记忆容量处理等通信和计算机领域。

2015 年 3 月 6 日，工信部印发《2015 年工业强基专项行动实施方案》中明确提到“关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向，提升材料保障能力。”

随着终端市场对高保密性、高传送质量的追求，使得移动电话、汽车电话，无线通信向高频化发展。同时，高信息量传送、卫星通信的使用频率将会提高，倒逼微波通信和光纤通信必须高频化，市场对高频覆铜板的需求将会越来越大。

3、提升产品技术含量、维持行业竞争地位

刚性覆铜板当前仍是公司的主要创收产品，2016 年全年覆铜箔板的营业收入占比达到 32.52%。随着中低端覆铜板逐渐更新换代，如不能迅速调整产品结构，公司在将来的市场竞争中将面临十分被动的局面。为了保持与市场需求发展趋势相匹配，公司必须加大新型覆铜板的投入，尽快具备高精密电路板的生产能力，提升 FR4-HDI 专用薄板和高频覆铜板的产能规模，以保持公司未来的长期

快速发展，实现利润增长与市场开拓的良性循环，进一步巩固公司的市场竞争地位。

（三）项目实施的可行性

1、公司具有多年覆铜板生产经验

经过二十年的积累和创新，公司已经形成一系列成熟的企业管理体系，为公司生产经营和发展覆铜板业务提供了强有力的人才、体系的保障。同时经过多年的覆铜板生产所累积下来的工艺技术，都是确保本项目顺利实施的前提。

2、公司具有完善的覆铜板销售团队及网络

公司凭借稳定的产品质量、准时的交货期，继续强化市场营销推广，深挖已有市场资源，与骨干客户飞利浦、美的空调、欧普光电、松下、立讯精密、依顿、宏仁、胜宏科技、奥斯康等多个国内外知名企业深度的战略合作。

公司通过使用销售管理移动终端平台，降低因子公司分处多地导致销售人员分布分散、沟通缺失等引发的营销管理效率低的风险。同时，公司非常重视营销队伍建设，通过建立垂直产业链上各细分市场的营销体系和对各子公司内部建立差异化的管理体系，公司整体发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，稳步推进市场开发，不断扩大市场占有率。公司完善的营销网络和队伍，是本项目实施的重要保障。

3、完善的技术研发体系

公司与哈尔滨理工大学等研发机构成立高频覆铜板共同研发项目，并已经取得相关研发成果，为本项目顺利实施提供了技术保障。

（四）项目投资估算

本项目总投资 37,565.93 万元，其中建设投资 32,615.60 万元，铺底流动资金 4,950.33 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 31,040.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 13.16%，投资回收期（税后）为 7.69 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010188）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 600 万张高端芯板项目环境影响报告书的批复（梅市环审[2017]28 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

四、年产 700 万平方米 FCCL 项目

（一）项目基本情况

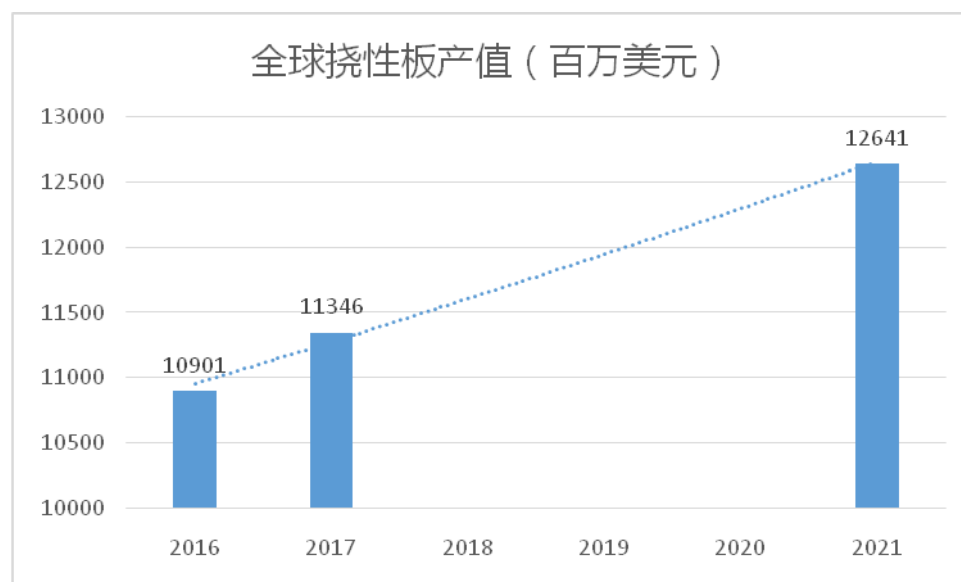
- 1、项目名称：年产 700 万平方米 FCCL 项目
- 2、项目建设单位：梅州超华电子绝缘材料有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市
- 4、项目性质：新建
- 5、主要产品：3-FCCL（有胶）、2-FCCL（无胶）、覆盖膜
- 6、项目总投资：项目总投资 26,575.29 万元，其中建设投资 21,359.45 万元，铺底流动资金 5,215.84 万元
- 7、项目建设周期：12 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，引进国际先进设备，新增 700 万平方米 FCCL 及 500 万平方米覆盖膜产能。

（二）项目实施的必要性

- 1、挠性覆铜板（FCCL）是 PCB 行业的重要原材料

近年来，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为主的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的挠性印制电路板（FPC）市场发

展。根据电子行业咨询机构 PrismaMark 发布的数据表明，2016 年全球 PCB 行业总产值 542.07 亿美元，细分品类中 FPC 总产值为 109.01 亿美元，占比 20.11%。预计 2021 年 FPC 年产值将达到 126.41 亿美元，占比可进一步上升至 20.92%。



数据来源：PrismaMark

FPC 中的重要原材料之一就是 FCCL。传统的 FCCL 产品是由铜箔、薄膜、胶粘剂三个不同材料、不同功能层所复合而成的，因此又称它为“三层型挠性覆铜板”（3-FCCL）。近几年，有一种产品结构的 FCCL 在应用方面得到很快的发展，这就是无胶粘剂的挠性覆铜板，称为“二层型挠性覆铜板”（简称“2-FCCL”）。2-FCCL 与 3-FCCL 相比，具有耐温性能更好、尺寸稳定性更好、抗剥离强度更高、更加薄型化、耐折性更好等性能特点。3-FCCL 与 2-FCCL 性能指标及应用领域具体如下表：

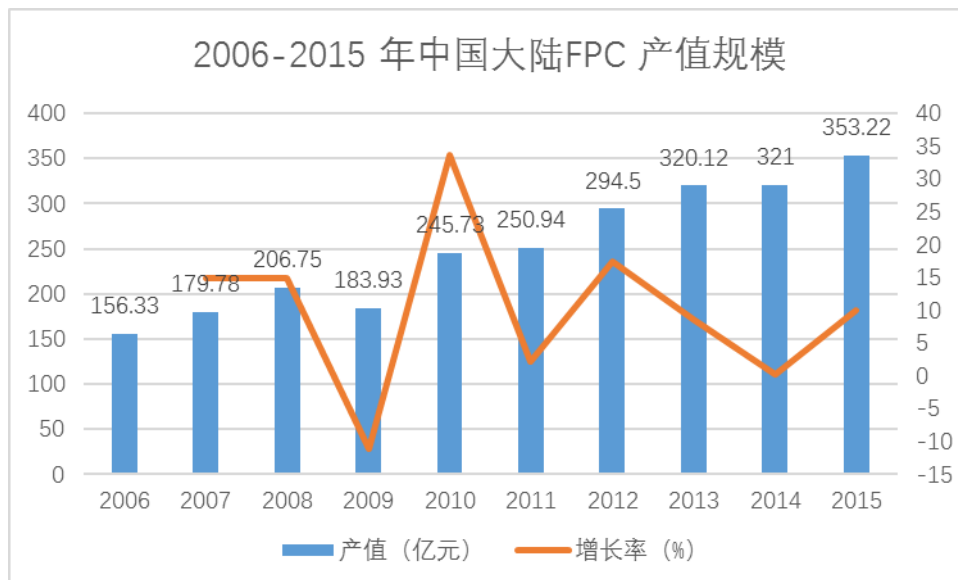
产品类型	最小厚度 (mm)	抗剥离强度 (kgf/cm)	尺寸稳定性 (%)	适用领域
3-FCCL	39	1	0.08	汽车、LED、手机、电脑与周边、医疗和检测仪器等
2-FCCL	30	1.1	0.06	汽车、手机、电脑与周边、摄影器材、智能手表和手环、航空等

目前，由于智能终端轻薄化的趋势越来越明显，市场对于高端 2-FCCL 的需求量将会越来越大，与此同时，3-FCCL 依然具有较大的存量市场，例如：汽车、LED、手机等电子产品的 FPC 依然以 3-FCCL 为主要原材料。

总体来说，FPC 是 PCB 行业的主要发展趋势之一，本项目实施后公司将具备 2-FCCL 及 3-FCCL 的生产能力，对公司顺应行业发展趋势、巩固 PCB 行业地位具有重大意义。

2、紧抓 FPC 行业向大陆地区转移的机遇

近年来，日本、韩国和台湾生产成本持续攀升，FPC 产业开始了新一轮的产业转移。发达国家的 FPC 制造商纷纷在中国投资设厂，中国作为 FPC 产业主要承接国，在新一轮产业转移浪潮中受益。目前，中国地区 FPC 产值占全球产值的比值不断提升，已从 2005 年的 6.74% 提高至 2015 年的 47.97%，处于全球领先地位。



数据来源：中国产业信息网

受全球 FPC 产业转移的影响，大陆地区 FPC 产值持续保持高速增长，2006-2015 年年均复合增长率达 8.49%。FPC 产能向大陆地区的不断集中，带动 FPC 产品的主要原材料 FCCL 市场将进一步向大陆地区集中，国内 FCCL 产品供应商将从中获益。

根据中国覆铜板材料协会（CCLA）统计，2016 年全国 FCCL 产品及相关制品销售收入 25.57 亿元，销售数量达 5,437 万平方米，较 2015 年同比增长 6.70%，取得了较大增长。同时，随着国产 FCCL 产品技术含量的不断提高，进口替代率将不断上升，我国 FCCL 产业市场规模将取得进一步突破。

3、完善公司产业链，优化产品结构

公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，坚持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，产品覆盖包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，为客户提供“一站式”产品服务。

目前公司的业务核心主要在刚性板领域，着手布局 FCCL 产业是公司完善柔性线路板行业产品布局的新起点，同时也是公司发掘新盈利增长点的重要举措。

（三）项目实施的可行性

1、引进国际先进设备，生产工艺成熟

公司将从日本引进国际先进的 FCCL 生产设备，构建产能、性能达到国际水平的高端 FCCL 生产线，以保证公司生产的 FCCL 在品质上具有较强的市场竞争力。同时，公司本次 FCCL 项目将采用工艺较为成熟的层压法进行生产，以保证生产速率，保障产品质量稳定可靠。在本项目实施前，公司对生产设备及生产工艺方面已经做了充分的调研及论证，本项目实施不存在实质性障碍，具有可行性。

2、通过加大研发，满足 FCCL 原材料需求

FCCL 产品的主要原材料包括聚酰亚胺薄膜(PI)、热塑性聚酰亚胺薄膜(TPI)和高精度电子铜箔等。

为确保公司产品质量，目前公司 FCCL 项目计划以进口原材料为主，但公司将同时加大对聚酰亚胺薄膜及热塑性聚酰亚胺薄膜的研发投入，加深公司在 FCCL 原材料领域的技术积累，为实现关键原材料的自主供给提供保证。

同时，随着下游终端应用领域对于 FCCL 轻薄的需求越来越高，厚度 9 μ m 以下的压延铜箔因受其生产工艺的限制，铜箔性能将会发生改变，难以满足 FCCL 的生产需求。因此在 9 μ m 规格以下的超薄 FCCL 领域，电解铜箔将取代压延铜箔的应用。公司已进入试产阶段的“年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程”项目（一期）中已预留部分产能用于 FCCL 专用铜箔的生产，此举将进一步保障公司 FCCL 产品的市场竞争力以及产品稳定性，为本项目顺利实施提供了保障。

3、对行业的深度理解，充分了解客户需求

公司是 PCB 行业中少数具有垂直一体化产业链的制造型企业之一，深入了解 PCB 行业全产业链的市场发展状况。

FPC 是 PCB 领域中最具发展潜力的细分领域。据 PrismaMark 预测，2017 年挠性板的产值年增长率为 4.1%，增长幅度在五大 PCB 品种中位居第一。2021 年 FPC 仍成为需求增长最大的品种，其在 PCB 各类品种的总产值所占的比例，将由 2016 年的 20.1%，提升到 20.9%。

公司所生产的 FCCL 将在满足下游客户需求的基础上，不断与时俱进，以公司研发中心为核心加大相关研发投入，包括对国际领先的化学法及涂布法进行开发，以满足下游客户对 FCCL 轻薄性能的需求。

4、丰富的制造业管理经验

公司自成立以来一直从事 PCB 相关材料和产品的生产制造，公司管理层具有丰富的生产管理相关经验，同时公司本次引进的生产设备自动化程度高，保障了本项目生产产品的良品率，为本项目实施提供了可行性。

（四）项目投资估算

项目总投资 26,575.29 万元，其中建设投资 21,359.45 万元，铺底流动资金 5,215.84 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 20,296.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 14.15%，投资回收期（税后）为 7.94 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010189）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 700 万平方米 FCCL 项目环境影响报告

书的批复（梅市环审[2017]29号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第4811号）。

五、本次非公开发行对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司的资本实力与生产规模将进一步提升，产业链将得到扩展，产品结构将得到优化。本次非公开发行将有利于公司巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升；另一方面，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

通过本次非公开发行募集资金，公司的资产负债率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升，这将有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，并为公司后续债务融资提供良好的保障，增强公司长期持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

六、可行性分析结论

本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日